

刊期	Cover Story	Trend & Analysis				Design & Technology			Specials*	Trade Show Distribution
		業界趨勢	思維與觀點	精英訪談	創新天地	設計新技術	測試與測量	設計揭密		
1 月號	新年展望	•	•	•	•	EMI/EMC 電路保護 雷達技術	網路分析儀	•		
2 月號 (Digital)	碳中和、碳達峰要求下的電源管理技術	•	•	•	•	馬達控制 RF/ 微波 伺服控制	示波器	•		
3 月號	軟體定義的汽車新架構	•	•	•	•	人機介面 觸控技術 語音辨識 / 處理	測試軟體 /IP	•		
4 月號	EDA 工具新趨勢	•	•	•	•	5G 通訊 無線連結 視訊監控	微波射頻測試	•		
5 月號	邊緣運算	•	•	•	•	PCB 設計 高頻設計 嵌入式設計	電源完整性測量	•		
6 月號	基於 Arm 和 RISC-V 核心 MCU 設計	•	•	•	•	可穿戴裝置設計 能量採集 數位訊號處理	向量訊號分析	•		
7 月號 (Digital)	寬能隙功率元件 EV 應用	•	•	•	•	智慧電網 無線通訊 類比電路設計	頻譜分析儀	•		
8 月號	新「摩爾定律」-- 異質整合	•	•	•	•	混合訊號電路設計 資料安全與加密 MCU	EMI 測試	•		
9 月號	手機廠商自研 ISP 風潮之謎	•	•	•	•	醫療電子 ADC/DAC 邊緣運算	阻抗測量	•		
10 月號	可攜式裝置多重無線技術測試	•	•	•	•	功率元件 低功耗設計 數位電源	混合訊號測量	•		
11 月號	儲存技術的「5」時代 (DDR5/PCIe 5.0)	•	•	•	•	音訊設計 FPGA/DSP 晶圓代工	訊號完整性測量	•		
12 月號 (Digital)	人工智慧與先進製造	•	•	•	•	LED 照明 光電及顯示 MEMS 感測器	嵌入式系統測試	•		

編輯查詢

有關台灣版的編輯及其他相關事項查詢，請與 Judith Cheng (judith.cheng@aspencore.com) 聯繫。

備註：發行人保留對以上文章刪修的權利。